

## 災害時における相互協力に関する合意書

一般社団法人電子情報技術産業協会半導体部会（以下「JEITA 半導体部会」という。）に加盟する下記の 12 社（以下「会員会社」という。）は、災害時において相互協力によって製品供給の継続に努め、顧客ひいては社会の発展に貢献できるよう、次の通り合意する。但し 本件合意は法的義務を伴わない。

### 記

1. 地震その他の災害により被害を受けた会員会社が、他の会員会社に部材等の融通を要請した場合、援助を求められた会員会社は、被災した会員会社に対し相互扶助の精神で自ら適当と認める援助を行うよう努める。
2. 会員会社は、前項にもとづく援助が円滑に行われるよう、災害時における会員会社間の連絡体制をあらかじめ整備し、これを維持する。
3. 本合意は、参加を希望する企業に対して開かれており、JEITA 半導体部会に加盟することにより、本合意に参加することが可能である。

平成 30 年 1 月 29 日

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社  
東芝デバイス&ストレージ株式会社  
東芝メモリ株式会社  
パナソニック セミコンダクターソリューションズ株式会社  
富士通セミコンダクター株式会社  
マイクロンメモリ ジャパン株式会社  
ルネサス エレクトロニクス株式会社  
ローム株式会社  
住友電工デバイス・イノベーション株式会社  
富士電機株式会社  
三菱電機株式会社  
株式会社デンソー

(別紙)

「災害時における相互協力に関する合意書」参加企業一覧  
(2019年5月30日現在)

- ・ ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
- ・ 東芝デバイス&ストレージ株式会社
- ・ 東芝メモリ株式会社
- ・ パナソニック セミコンダクターソリューションズ株式会社
- ・ 富士通セミコンダクター株式会社
- ・ マイクロンメモリ ジャパン合同会社
- ・ ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・ ローム株式会社
- ・ 住友電工デバイス・イノベーション株式会社
- ・ 富士電機株式会社
- ・ 三菱電機株式会社
- ・ 株式会社デンソー
- ・ キヤノン株式会社

以上